平成２４年７月２日

各　　位

会　社　名　株式会社日本マイクロニクス
代表者名　代表取締役社長　長谷川正義
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６８７１）
問合せ先　専務取締役企画管理本部長 藤崎直子
Ｔ　Ｅ　Ｌ　０４２２－２１－２６６５

パワー半導体テストソリューション提供開始に関するお知らせ

当社はこの度、省エネ技術で注目されるパワー半導体のウェーハテスト向けにウェーハプローバ「PW-8000」と大電流用プローブブロック「HCP-4」の２製品の販売を開始することとなりましたので、お知らせいたします。

記

１．開発・製品化の背景

省エネルギー化・環境対策への意識の高まりにともない、パワー半導体の需要のすそ野が広がり、技術や製品が進化してきております。検査におきましても、パワー半導体の実装が、小型化・機能集約化の流れから、マルチチップパッケージやインテリジェントパワーモジュール（複数チップをワンパッケージに組み込む実装方法）を採用するにあたり、従来実装後に行っていた動特性検査を、実装前に実施し、不良チップの搭載を防ぐ必要性が生じてきました。しかし、パワー半導体は通常のロジックやメモリとは大きく異なる特性のため、効率の良いウェーハ検査工程での評価には課題が多く、これを実現するシステムの要求が高まっていました。

２．装置概要

２－１．ウェーハオートプローバ　Model：PW-8000

＜主な特長＞

・最大3000Vまでの高耐圧評価に対応
・1000Aクラスの大電流・動特性検査を実現
・最小10μ秒のパルス測定対応により発熱影響を回避
・100μΩオーダの低オン抵抗の測定が可能
・ウェーハ薄厚50μmまで安定した自動搬送可能な非接触搬送機構を採用

＜主な仕様＞

・対応ウェーハサイズ　：　最大8インチ
・最大測定電流　　：　1,200A(Pulse)　※当社製コンタクタ「HCP-4」使用の場合
・最大測定電圧　　：　3,000V
・残留抵抗　　：　0.1mΩ以下
・残留インダクタンス　：　100nH以下
・オプション　　：　TAIKO ウェーハ、温調機等

＜その他＞

本製品での特性評価は、アジレント社B1505A「パワーデバイスアナライザー／カーブトレーサ」および「超高電流ユニット」で検証済みです。



Model PW-8000

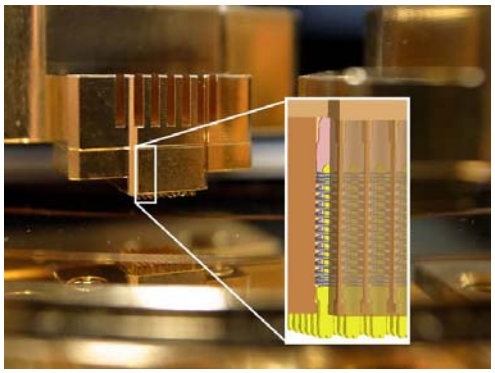
２－２．大電流用プローブブロック　Model：HCP-4

＜主な特長＞

・PADサイズ5mmx5mmで1200A以上の通電が可能
・小さな導体抵抗で、誤差を低減
・長寿命かつ優れた接触安定性のコンタクトピンを使用
・接点温度の上昇を抑える独自の多点接触構造を採用
・ピン単位の交換が可能等、メンテナンス性に優れる

＜主な仕様＞

・ 最小ピッチ　　：0.4mm
・ 対応電圧　　：最大3000V
・ 最大電流　　：10A/１pin



HCP-4 搭載外観とピン構造図

３．その他

2012 年 7 月より販売を開始いたします。

製品に関するお問い合せ先
半導体機器事業部　営業統括部　システム営業部
TEL 0422-21-0194

以　上